

X8011-II PCB

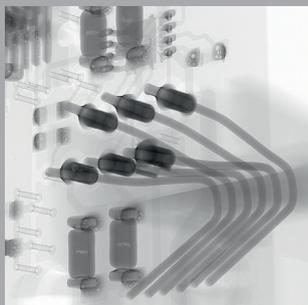
Raggi X offline di elevata precisione -
Soluzione intelligente
orientata al futuro



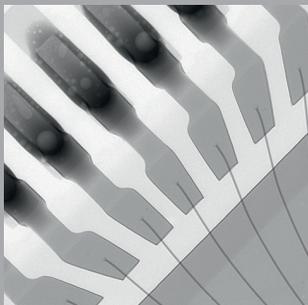
3D-MXI

Con Quality Uplink!

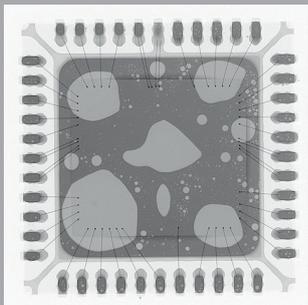
Eccezionale qualità delle immagini, proc



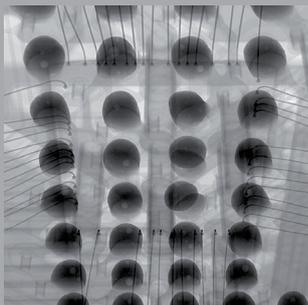
THT con irraggiamento-obliquo



QFP con irraggiamento ortogonale



QFN con irraggiamento ortogonale



BGA con irraggiamento inclinato

Riunisce in un unico sistema la velocità delle ispezioni automatiche alla precisione delle ispezioni a campione

Ciclo di vita estremamente lungo, utilizzo flessibile

Potenti tubi di trasmissione aperti con microfocus, tubi diretti chiusi opzionali

Ingrandimenti elevati e immagini di qualità eccezionale

Impiego di pannelli rilevatori piani di alta qualità

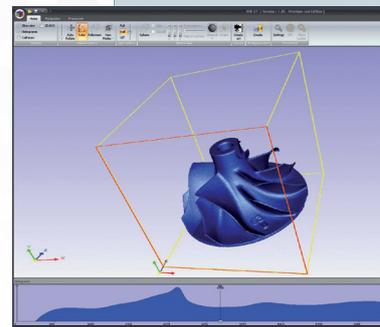
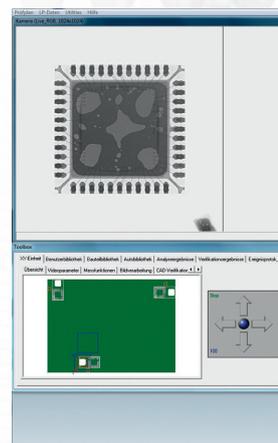
Di semplice utilizzo, funzioni di analisi avanzate: Viscom XMC e Viscom SI

Estendibile con tomografia computerizzata di Viscom

Principio EasyClick per un facile montaggio delle unità di handling

Quality Uplink per classificazione e controllo di processo semplificati

Assistenza professionale in loco, telefonica e remota, in tutto il mondo



Analisi XVR-CT di Viscom

I componenti come BGA, QFN e QFP sono sempre più spesso utilizzati nella produzione di SMD. Poiché i collegamenti rimangono per la maggior parte dei casi nascosti, molte saldature possono essere controllate in modo affidabile soltanto con i raggi X. Il sistema di ispezione a raggi X ad alta risoluzione X8011-II PCB è stato sviluppato appositamente per questo tipo di applicazioni. Fra le tipiche applicazioni rientrano ad esempio le ispezioni di componenti elettronici e assemblati, il controllo di qualità nel settore dell'elettronica di potenza o le ispezioni speciali non invasive. Con X8011-II PCB, i produttori di componenti elettronici potranno adottare una soluzione offline senza rinunciare alle eccezionali routine automatizzate della famiglia AXI X7056 di Viscom. Il supporto sia dell'analisi a raggi X automatizzata (Viscom SI) che dei controlli manuali o semiautomatici (Viscom XMC) rende questo sistema particolarmente flessibile.

essenti ottimizzati

Controlli di elevata qualità, massima flessibilità del sistema

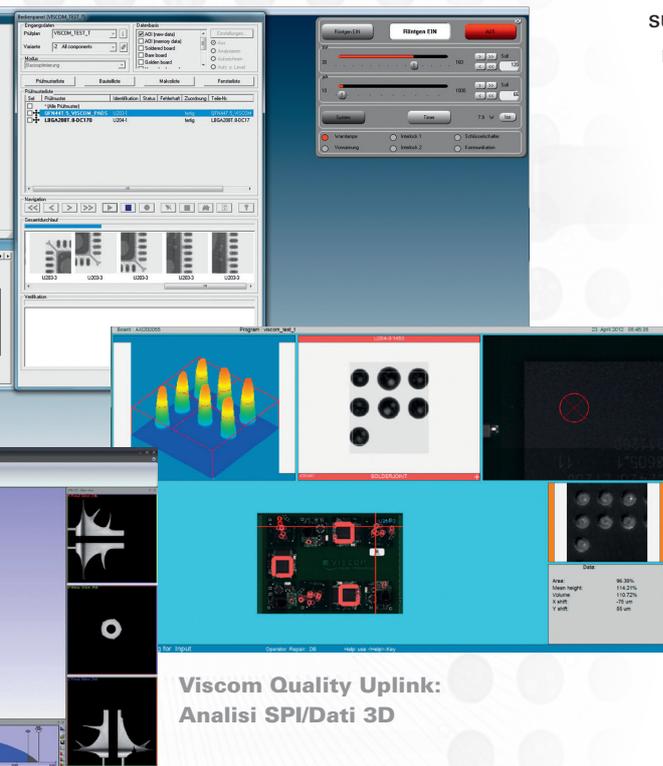
X8011-II PCB di Viscom offre un **sistema di ispezione a raggi X intelligente ed economico**. I campi applicativi comprendono le **analisi di campioni**, le **ispezioni speciali** di singoli componenti, il lancio di **nuove produzioni** e le **ispezioni di serie**. Grazie all'integrazione delle analisi automatiche SI, il sistema è ideale per la produzione **High-Mix-Low-Volume**.

Il cuore della tecnologia a raggi X è il **tubo di trasmissione aperto con microfocus di Viscom** (fino a 200 kV) di alta risoluzione. A scelta è anche possibile utilizzare anche un **tubo diretto chiuso** (fino a 130 kV). Entrambi i tubi offrono un **irraggiamento particolarmente stabile in modalità d'uso continuo**. Gli **ingrandimenti elevati** e l'**alta qualità** delle immagini per visualizzare i risultati vengono ottenute con **pannelli rilevatori piani ad alta definizione**. Il **sistema modulare** di Viscom, concepito per facilitare il lavoro quotidiano, è in grado di offrire a tutti gli utenti le **migliori funzionalità di controllo**.

Per i controlli speciali o per i componenti particolari è a disposizione il **software XMC di Viscom**. Grazie ad un'**interfaccia intuitiva** e ad una **vasta gamma di funzioni di analisi** è possibile controllare i prodotti oggetto di verifica in modo veloce e preciso. Sono inoltre disponibili le **ricostruzioni 3D** con la **tomografia computerizzata XVR** di Viscom. In questo modo oltre ad una migliore **localizzazione degli errori** è anche possibile rendere visibili singoli **strati** o **sezioni**.

Un punto di forza del sistema è l'**analisi a raggi X completamente automatizzata** con il software SI di Viscom. Questo software, **sviluppato appositamente per la produzione SMD**, vanta oltre 30 anni di utilizzo nei processi di ispezione di prodotti assemblati. La tipica estensione dei controlli offerta dai sistemi in linea X7056 diventa così disponibile anche per le applicazioni offline. Un ulteriore vantaggio è costituito dall'**interfaccia comune**. Questa soluzione permette un maggior **risparmio nei corsi di formazione** e una **migliore comunicazione fra i diversi sistemi di ispezione**.

Con X8011-II PCB è possibile utilizzare la pratica funzione **Viscom Quality Uplink**. Mediante il collegamento dei risultati di ispezione da SPI, AOI, AXI e MXI, questa funzione supporta una **classificazione semplificata** e un **controllo di processo efficace**. Ad esempio è possibile visualizzare tutti i dati generati dall'ispezione 3D Viscom della pasta di saldatura direttamente nella postazione di verifica del sistema X8011-II PCB. **L'identificazione semplificata delle cause dei difetti permette di ottimizzare i processi in modo più agevole**. Il sistema X8011-II PCB rende le **ispezioni con raggi X** adatte all'utilizzo in una vasta gamma di applicazioni.



Viscom Quality Uplink:
Analisi SPI/Dati 3D

Moduli universali e flessibili per un handling perfetto dei pezzi da ispezionare



Banco



Modulo di rotazione



Asse di ribaltamento/rotazione motorizzato



Asse CT

Dati tecnici

X8011-II PCB *eco* | X8011-II PCB *plus* | X8011-II PCB *flex*

Raggi X

Tubo raggi X	Tubo diretto chiuso o tubo di trasmissione con microfocus aperto, (come optional anche tubo TXD, < 1,5 µm)		
Alimentazione	10 - 130 kV / 10 - 160 kV / 10 - 200 kV		
Corrente	50 - 300 µA / 5 - 1000 µA		
Potenza target	Max. 20 W / max. 40 W	Max. 40 W	
Ingrandimento geometrico	Max. 35 x / max. 2650 x	Max. 2650 x	
Elaboratore immagine alta risoluzione	Alta risoluzione	Diagonale	
Risoluzione comprovata (a 90 kV/80 µA)	7,3"-FPD, 14 bit	11"-FPD, 14 bit	
Risoluzione comprovata (a 90 kV/80 µA)	< 16 - 50 µm / < 4 µm / < 1,5 µm		
Rotazione rivelatore	0°	0 - 60°	0 - 60°
Aggiuntivo mediante asse rotazione/ribaltamento +/- 45° (90°)			
Cabina raggi X	Conforme norme dispositivi di protezione come legge tedesca su protezione radiazioni, direttiva (Röv - German X-ray Regulation), norme CE e altre norme internazionali. Tasso di fuoriuscita < 1 µSv/h		

Software

Interfaccia utente	Viscom XMC / Viscom SI opzionale		
Pacchetti software disponibili	Software di analisi BGA Software di analisi QFN Software di analisi THT Software di analisi ACA (analisi superficiale) Software di analisi automatica SI Viscom Software XVR-CT (planare, rotativo) Postazione di verifica Viscom HARAN Viscom Quality Uplink per AOI, AXI e SPI di Viscom per l'ottimizzazione del processo		

Computer

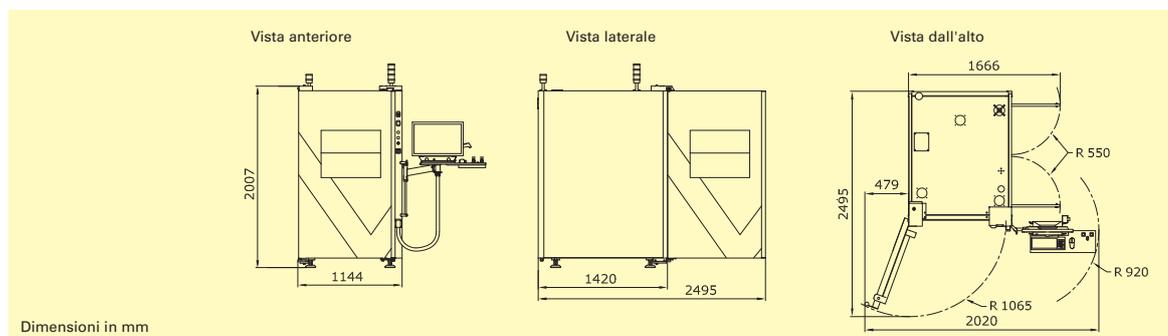
Sistema operativo	Windows®
Monitor	Display LED 24" ad alta risoluzione per la visualizzazione di valori di grigio in ambito SMT ed elettronica (DICOM Standard)

Handling

Manipolatore	X-Y-Z	X-Y-Z più modulo di rotazione
Max. Area movimentazione banco	Orizzontale asse x/y: 460 mm x 435 mm Verticale asse z: 290 mm	
Max. Area movimentazione modulo di rotazione	Orizzontale asse x/y: 350 mm x 430 mm Verticale asse z: 290 mm n x 360°	
Max. Peso pezzo	10 kg (con modulo di rotazione 5 kg)	
Sostituzione pezzo	Finestra motorizzata	
Altri assi opzionali	Sì	

Altri dati del sistema

Alimentazione	230 V, (altre tensioni a richiesta), 1P/N/PE, 16 A
Dimensioni del sistema	Circa 1144 mm x 2007 mm x 1420 mm (L x H x P)
Peso	Circa 2100 kg



www.viscom.com

Sede centrale:

Viscom AG
 Carl-Buderus-Straße 9 - 15 · 30455 Hannover
 Tel.: +49 511 94996-0 · Fax: +49 511 94996-900
 info@viscom.de · www.viscom.de



SISTEMI STRUMENTI www.pcbtech.it
www.epcb.it

Viale Beniamino Gigli, 15
 60044 Fabriano AN
 info@pcbtech.it
 Tel. +39 0732 250458
 Fax +39 0732 249253
 C.F./P.I. 01474230420